SP-325
软性透明易剥除灌注胶

特　　点

- SP-325为双剂型透明硅质灌注胶，流动性佳，混合容易，操作方便。
- 低收缩，适合应用于对温度与应力敏感的组件或模块。
- 柔软性好，对于机械性振动可提供一定缓冲性。
- 软性弹性体容易以工具外力去除，方便维修。维修后，可在修复位置重新灌胶填补。

用　　途

- 需透明灌注或防水耐候要求，如室内外LED灯模块、卫浴设备电子机板。
- 需选择性挖除或整片剥除的灌注模块，如保险丝座、模块维修或组件更换。
- 经常性机械振动，需振动缓冲或是零件固定的电路基板灌注或厚膜披覆。

物　　性

		A 剂	B 剂
颜　　色		透 明	透 明
黏　　度		1,050 ~ 1,650 cps	1,250 ~ 1,850 cps
混 合 比	重量比	100	: 100
混合后黏度	@25°C	1,100 ~ 1,600 cps	
可操作时间	@25°C	50 ~ 70 分钟	
硬化条件	@25°C	18 ~ 24 小时	
工 作 温 度		-60°C ~ +200°C	
破 坏 电 压		20 kV/mm (508 Volts/mil)	
硬　　度	Shore A	12 ~ 18	
体 积 电 阻		2×10^{14} ohm-cm	
绝 缘 常 数	1MHz	3.0	
消 散 因 素	1MHz	2.1×10^{-3}	
保 存 期 限	@25°C	6 个月 (未开封)	

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　苏州：86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976

注 意 事 项

1. 使用前，请先将混合用器具、欲灌注基板或模块表面清洁干净。以免混入杂质或污染，影响透明度或造成灌注成品外观不佳。
2. 如果灌胶成品内部包裹气泡，建议降低灌胶深度，分次灌胶。或是在灌胶前后对于树脂或灌注模块进行真空脱泡(消泡时间建议10～30分钟)，以获得最佳外观。
3. 部分含有硫、磷、氮元素的有机化合物，可能会抑制或干扰硫化反应，而造成不易硬化。对于有使用脱模剂、含硫材料、或基板上有助焊剂残留物、有机金属化合物等，请先少量适用确定是否有影响，或是灌胶前加强清洁的工作。
4. 可操作时间与环境温度有关，温度愈高，可操作时间愈短；反之，可操作时间则愈长。
5. 开封后请尽速用完，或是密封避免受潮。